

证券代码：300327

证券简称：中颖电子

中颖电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号 2025-005

投资者来访类别	<div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他 投资者走进上市公司活动</div></div>
参与单位名称及人员姓名	东方证券、五矿证券
时间	2025 年 12 月 2 日
地点	会议室
上市公司接待人员姓名	宋永皓、潘一德、徐洁敏、黄杜
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>风险提示：</b></p> <p>本次调研涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构成本公司的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识。</p> <p>投资者关注的主要问题及回复</p> <p><b>1、 公司简单介绍？</b></p> <p>中颖电子成立于 1994 年，主营自主品牌的集成电路设计和销售，2012 年在深交所创业板上市，总部位于上海，在西安、合肥、深圳、香港设有分子公司。公司采用 Fabless 商业模式，主营工控级微控制芯片（MCU）、锂电池管理芯片（BMIC）和显示屏驱动芯片（AMOLED）三大产品线。具体来看，MCU 产品广泛应用于家电领域，包括大家电如冰箱、空调、洗衣机，以及小家电如电饭煲、电吹风等；BMIC 产品在消费端主要用于手机、笔记本电脑及智能穿戴领域的锂电池计量与保护，在动力端则应用于电动工具和电动自行车；AMOLED 显示屏驱动芯片主要用于智能手机和移动穿戴的显示驱动。市场份额方面，中颖电子在智能家电 MCU 大中华区厂商排名居前，动力电池管理 MCU 市场占有率处于头部位置，AMOLED 显示屏驱动芯片则是</p>



国内首个实现量产的厂商。25 年前三季度，营收 9.67 亿，归母净利润 0.57 亿。在产品规划上，公司将聚焦白色家电、智能家居、智能汽车、智能机器人等应用场景开展新品研发，例如变频电机 MCU、WiFi/BLE-MCU、车规 MCU、车规 AFE、人形机器人关节控制 MCU 等。战略目标是成为世界级 MCU 厂商。在企业战略上，要争取做 MCU、BMIC 领域单项冠军、IC 行业头部厂商。定位进口替代，做中国芯先行者。实施出海战略：1.0 海外市场；2.0 国际品牌；3.0 国际化；4.0 全球在地化。争取成为国际级的 IC 厂商。在业务战略上，以高品质、差异化产品巩固家电市场。推出车规 MCU、车规 AFE 进军汽车电子市场。布局智能机器人关节控制 MCU 产品技术。在职能战略上，把人才作为核心资产，有效激励。运用上市公司政策工具，整合资本市场资源。强化供应链管理，坚持合作共赢。严把质量关，追求客户满意度。未来将采用内生式增长+外延式并购双引擎驱动发展模式，进一步加强治理和管理，力争成为世界级、国际化的 MCU 芯片设计企业。

**2、公司 2022 年归母净利润达 3.23 亿元,2023 年降至 1.86 亿元,2024 年进一步回落至 1.34 亿元，净利润连续两年下滑。请问核心原因是什么？针对营收和利润端的下行压力，公司在产品结构优化、市场拓展方面有哪些具体的应对措施？**

(1) 主要是售价下滑及晶圆代工成本偏高,导致毛利率下滑而影响归母净利润。自 2022 下半年起集成电路行业发生较为剧烈的周期性反转的下行变化,同时更多的国产 MCU 芯片设计公司也因为 2021 年的产能吃紧,有机会窗口加入赛道,使竞争加剧,导致产品售价在 2023 及 2024 快速下行.公司的产品销售量维持稳步增长,2022 年 7.13 亿颗, 2023 年 8.12 亿颗,2024 年 8.85 亿颗,平均复合增速率高于 10%;公司在 2021 年产能紧缺的时候,迫于形势与晶圆厂签订了长期产能协议,也导致了晶圆代工成本偏高;(2) 在产品上,公司的 MCU 新产品都以 32 位内核为主,在白电的变频电机市场持续扩大份额,未来新产品也规划以 12 吋 55nm 的制程为主,更多的与境内晶圆厂合作,进一步优化成本结构;市场面上,公司有效拓展了海外品牌家电大客户销售,现正处于上量阶段, 销售接近千万级别,预期明年增速不错,长期可望持续增长。



3、从财务数据来看，公司 2023 年经营活动现金流净额为- 2970 万元，2024 年恢复至 1.83 亿元，2025 年三季度仍保持 1.71 亿元的正向净额。请问现金流波动的核心影响因素是什么？公司在应收账款管理、经营性现金流稳定性方面有哪些长效机制？

2023 年经营活动现金流净额为负，主要是公司为了履行长期产能保障协议，采购了比销售所需还多的晶圆，但 2024 年及 2025 年前三季度的晶圆采购量对比 2023 年都稍有下降，公司与晶圆厂沟通允许降低采购规模，以消化公司存货为优先；公司在应收账款管理一职比较严格、回款平均在 90 天内。

4、公司主营 MCU、BMIC、AMOLED 驱动芯片三大类产品，近三年营收规模从 2022 年 16.02 亿元降至 2024 年 13.43 亿元。请问不同品类芯片的营收贡献占比是否发生变化？面对消费电子、家电等下游市场的需求波动，公司在产品研发和客户拓展上有哪些重点布局？

不同品类芯片的营收贡献近几年稍有变动，但是不大，2022-2024，一直维持在 MCU 占比 55-60%，BMIC 占比 25-30%，AMOLED 驱动芯片占比 10-15%；关于 MCU，公司的 WiFi-MCU 已经在市场推广，研发上已经开始投入机器人关节 MCU 开发；公司在手机端锂电池管理芯片的国产品牌客户由 5 家扩充为 6 家，基本国内的大品牌客户已实现全覆盖，今年也推出 PD 协议产品，已进入市场推广，笔记本计算机的计量芯及车规级的 AFE 芯片在开发中；AMOLED 显示驱动会推出 1.5K 屏解析率的新品。

5、公司 2024 年投资活动现金流净额为- 1.63 亿元，2023 年为- 9978 万元，持续呈现净流出状态。请问这部分资金主要投向了哪些领域（如研发、产能、新业务）？相关投入预计何时能转化为营收和利润增长，是否有明确的业绩考核目标？

2023 及 2024 的变动主要是投资理财投入金额大于到期金额。公司只选 R1 风险以内的产品。

6、近三年公司资产负债率维持在 19%-24%区间，整体财务杠杆较低，偿债能力稳健，但净利润率呈下降趋势。请问公司如何平衡研发投入、市场拓展与盈利水平之间的关系？未来在提升产品毛利率、增强盈利能力方



	<p><b>面有哪些具体规划？</b></p> <p>公司会评估研发及市场投入的收益及风险, 有长中短期的布局来平衡；未来在提升产品毛利率、增强盈利能力方面, 将进一步优化供应链管理, 提升新产品研发的效率、差异化及难度. 借助 AI 并关注 AI 端侧 MCU 的市场机会。</p> <p><b>7、如何进一步加强 ESG 工作，提升评级？</b></p> <p>ESG 已深度融入公司运营和产品设计核心。我们的产品设计本身就在践行环保理念。通过降低家电和手机类产品的功耗，公司每年为社会实现大量间接碳减排。在内部治理上，公司已完成数字化 2.0 升级，并计划在 2026 年实现智能化 3.0，引入 AI 技术提升运营效率。在社会责任方面，公司注重培养员工的公益意识而非单纯捐款数额。我们确保每笔善款 100%直达受助者，同时通过“心愿树”等项目鼓励员工参与社区公益活动，帮助公司所在街道社区困难家庭的孩子实现微心愿。公司正将云南绿春县的助学项目做成标杆，通过改善校园照明和饮水系统，切实提升当地教育条件。</p>
附件清单（如有）	
日期	2025 年 12 月 2 日